第四节经营情况讨论与分析一、概述2019年，全球宏观经济持续下行，叠加贸易摩擦等因素影响，PCB行业面临更激烈的竞争环境。随着国内启动5G投资建设，大数据、云计算、物联网等行业快速发展，驱动国内PCB行业需求在下半年有所复苏，全年呈现先抑后扬的发展态势。报告期内，公司各项工作围绕“降本增效、卓越运营”的主题开展，除聚焦PCB、半导体两大战略业务外，重点开展预算管控和费用控制、绩效管理体系的逐步分解落地、薪酬福利套改完成实施、信息化系统全面拉通并持续优化、营销体系流程优化、推动“研、产、销”协同、PCB班组能力建设、数字化工厂建设全面推进等基础工作。另外，在人才发展方面，重点开展了精益六西格玛项目、基础工艺知识培训项目、内训师项目等。报告期内，公司运营情况平稳，实现营业收入380,372.22万元，同比增长9.51%；总资产520,101.31万元，同比增长9.96%；净资产283,137.13万元，同比增长11.33%；营业利润35,554.04万元，同比增长28.96%；利润总额35,395.48万元，同比增长28.23%；归属于上市公司股东的净利润29,191.67万元，同比增长35.95%。销售收入保持平稳增长，主要来自IC封装基板业务、半导体测试板业务以及SMT业务收入的增长。净利润增长的主要原因一方面是子公司经营情况大幅改善和提升，其中美国Harbor净利润由去年同期亏损2,936.38万元，到2019年度实现盈利1,754.04万元；宜兴硅谷净利润由去年同期亏损876.69万元，到2019年度实现盈利2,864.37万元；英国Exception由去年同期亏损473.02万元，到2019年度实现盈利212.67万元；上海泽丰净利润较去年同期增加2,254.85万元至4,626.12万元。另一方面实施的降本增效，加强预算管理的经营策略显现成效，期间费用同比呈现下降趋势，销售费用率下降0.59个百分点、管理费用率下降0.24个百分点，整体毛利率提升1.12个百分点，净利率提升1.53个百分点。报告期内，公司主营业务经营情况如下：（一）PCB业务增长整体平稳，子公司实现盈利目标报告期内，公司PCB业务保持平稳增长，实现销售收入292,156.38万元，同比增长4.54%，毛利率31.91%，同比提升1.07个百分点。子公司宜兴硅谷生产运营保持稳定、交付改善、良率提升，经营业绩显着改善、实现扭亏为盈，全年实现销售收入41,546.32万元、同比增长6.91%，净利润2,864.37万元；英国Exception公司各项成本管控取得成效、达成扭亏为盈的经营目标，实现销售收入7,041.94万元、同比增长18.01%，净利润212.67万元；Fineline受累于欧洲市场不景气，实现销售收入100,998.06万元、同比下滑8.70%，净利润7,630.10万元。（二）半导体业务取得较大进展，盈利能力改善报告期内，半导体业务取得较大幅度增长，实现销售收入80,159.96万元，同比增长39.75%，毛利率24.12%，同比提升8.37个百分点。其中，IC封装基板业务实现销售收入29,748.26万元,同比增长26.04%，毛利率17.68%，同比提升7.10个百分点，主要是因为行业景气度较高、订单饱满，工厂层面全年保持较高产能利用率，良率稳定保持在94%之上。半导体测试板业务受益于5G相关产业链拉动高端测试产品的需求，保持较快增长，实现营业收入50,411.70万元，同比增长49.33%，毛利率27.92%，同比提升8.56个百分点。其中，子公司美国Harbor成本管理成效明显，盈利能力大幅提升，实现销售收入32,945.98万元,同比增长27.36%，实现净利润1,754.04万元,实现扭亏为盈的经营目标。子公司上海泽丰实现营业收入18,596.91万元，同比增长131.87%，净利润4,624.12万元、同比增长95.17%。二、主营业务分析1、概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本（1）营业收入构成单位：元2019年2018年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计3,803,722,198.74100%3,473,258,603.48100%9.51%分行业PCB2,921,563,828.5676.81%2,794,816,276.7880.47%4.54%半导体801,599,625.1921.07%573,599,374.3716.51%39.75%其他80,558,744.992.12%104,842,952.333.02%-23.16%分产品PCB样板、小批量板2,921,563,828.5676.81%2,794,816,276.7880.47%4.54%半导体测试板504,116,994.4813.25%337,581,683.309.72%49.33%IC封装基板297,482,630.717.82%236,017,691.076.80%26.04%其他80,558,744.992.12%104,842,952.333.02%-23.16%分地区国内1,768,798,213.4546.50%1,524,626,140.2343.90%16.02%海外2,034,923,985.2953.50%1,948,632,463.2556.10%4.43%（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况√适用□不适用单位：元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业PCB2,921,563,828.561,988,665,043.1631.93%4.54%2.92%1.07%半导体801,599,625.19608,263,061.5224.12%39.75%25.86%8.37%分产品PCB样板、小批量板2,921,563,828.561,988,665,043.1631.93%4.54%2.92%1.07%半导体测试板504,116,994.48363,379,956.2527.92%49.33%33.47%8.56%IC封装基板297,482,630.71244,883,105.2817.68%26.04%16.04%7.10%分地区国内1,714,291,691.141,143,854,142.3333.28%16.36%15.40%0.56%海外2,034,923,985.291,468,665,022.4527.83%4.43%1.56%2.04%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用√不适用（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入√是□否行业分类项目单位2019年2018年同比增减PCB、半导体销售量元3,667,552,793.433,340,753,049.069.78%生产量元3,674,853,730.23,413,966,500.947.64%库存量元220,929,241.74213,628,304.973.42%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用√不适用（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况□适用√不适用（5）营业成本构成行业分类单位：元行业分类项目2019年2018年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重PCB直接材料1,365,537,880.4552.58%1,340,569,879.3555.50%1.86%PCB能源86,845,722.133.34%80,048,805.303.31%8.49%PCB人工工资323,219,900.3412.45%280,118,452.0411.60%15.39%PCB折旧100,555,565.653.87%95,564,554.223.96%5.22%PCB其它制造费用112,505,974.604.33%135,869,315.255.63%-17.20%半导体直接材料266,696,698.2610.27%180,433,195.967.47%47.81%半导体能源19,422,659.360.75%14,116,621.250.58%37.59%半导体人工工资177,379,181.596.83%163,843,683.356.78%8.26%半导体折旧43,285,691.471.67%42,597,445.551.76%1.62%半导体其它制造费用101,478,830.833.91%82,292,313.023.41%23.32%合计2,596,928,104.692,415,454,265.29说明无（6）报告期内合并范围是否发生变动√是□否报告期内，本公司之控股子公司Fineline新购买FuchsbergerPCB&ElectronicsGmbH、SpiritcircuitsLtd，子公司上海泽丰半导体科技有限公司新设立上海泽荃半导体科技有限公司，并纳入合并范围。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况□适用√不适用前五名客户合计销售金额（元）378,090,386.67前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例9.94%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%（8）主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况公司前5大客户资料序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例1客户一92,726,882.812.44%2客户二80,804,757.312.12%3客户三76,352,313.572.01%4客户四70,225,966.021.85%5客户五57,980,466.961.52%合计--378,090,386.679.94%主要客户其他情况说明□适用√不适用公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元）593,032,226.62前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例19.46%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%公司前5名供应商资料序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例1供应商一164,518,890.435.40%2供应商二143,717,527.824.72%3供应商三136,144,462.864.47%4供应商四76,014,497.512.49%5供应商五72,636,848.002.38%合计--593,032,226.6219.46%主要供应商其他情况说明□适用√不适用3、费用单位：元2019年2018年同比增减重大变动说明销售费用207,757,890.67210,045,091.10-1.09%管理费用345,515,337.62323,701,805.396.74%59,255,837.3835,514,803.5366.85%主要为汇率变动产生的汇兑收益减少及本期计提借款利息增加所致。财务费用研发费用197,840,530.75179,543,024.0410.19%4、研发投入√适用□不适用2019年度公司研发投入1.98亿元，组织研发团队对5G天线无源互调控制技术、高频高速信号完整性控制技术、涨缩大数据分析与预测等多个技术领域进行了系统研究和攻克，重点开发了埋线路封装基板、半导体测试板、5G天线板、77G汽车雷达板、400G高速光模块、超薄HDI刚挠板等产品，报告期内，技术攻克及产品开发阶段共申请专利92项，其中发明专利59项，共获授权专利102项，全面提高了我司产品的销售收入，并提升了我司研发创新能力及行业竞争力，促进我国高端印制电路板行业的快速发展，具体产品如下：（1）埋线路封装基板：以埋线路（ETS）封装基板关键技术及应用为研究方向，充分利用公司已有国际先进批量生产能力的封装基板生产基地以及技术基础和市场基础，开发自主知识产权技术，攻克35μm厚铜的MSAP流程线路制作，埋线路工艺开发、以埋线路方式制作高散热埋线路等关键技术，突破国外技术垄断，实现智能设备用厚铜的高散热埋线封装基板的开发与量产产业化，助力我国集成电路封装基板产业的快速发展。（2）半导体测试板：以半导体测试板关键技术及应用为研究方向，攻克了超高层对准度技术、微孔钻孔技术、高厚径比沉铜电镀技术、POFV技术、Encap技术、Viabond技术、超级平整度技术、高翘曲度技术、高速信号完整性控制技术等尖端线路板生产工艺技术，同时利用公司先进的产品线和专业的制造团队，该产品已通过国内外很多知名半导体终端客户的验证并建立稳定良好的合作关系，实现了规模化生产，该产品突破国外技术垄断，填补了国内空白，助力半导体科技的持续创新和发展。（3）400G光模块印制线路板：以高速信号传输和高密度互连关键技术及应用为研究方向，充分利用公司已有的国际先进的印制电路板批量生产技术和设计、制造、测试仿真的一站式服务技术，开发自主知识产权技术，攻克超低损高速材料加工技术、损耗测试技术、超高平整度埋铜技术、金手指超高耐腐蚀技术、高精度阻抗控制技术、小pitch邦定盘制作等关键技术，实现400G高速高密光模块印制线路板的开发，助力我国5G通信行业的快速发展。（4）5G天线印制线路板：以高频信号传输和高频新材料导入及应用为研究方向，充分利用公司已有的国际先进的印制电路板批量生产技术和设计、制造、测试仿真的一站式服务技术，开发自主知识产权技术，攻克无源互调技术、高频信号完整性控制与测量技术、高频混压技术、5G新材料导入与加工等关键技术，实现5G天线印制线路板的开发与量产产业化，助力我国5G通信行业的快速发展。公司研发投入情况2019年2018年变动比例研发人员数量（人）4103759.33%研发人员数量占比16.07%16.09%-0.02%研发投入金额（元）197,840,530.75179,543,024.0410.19%研发投入占营业收入比例5.20%5.17%0.03%研发投入资本化的金额（元）0.000.000.00%资本化研发投入占研发投入的比例0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显着变化的原因□适用√不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明□适用√不适用5、现金流单位：元项目2019年2018年同比增减经营活动现金流入小计3,947,327,235.383,761,628,169.394.94%经营活动现金流出小计3,433,869,514.383,428,437,666.770.16%经营活动产生的现金流量净额513,457,721.00333,190,502.6254.10%投资活动现金流入小计864,918,544.1745,936,927.861,782.84%投资活动现金流出小计1,230,877,308.97481,231,355.10155.78%投资活动产生的现金流量净额-365,958,764.80-435,294,427.2415.93%筹资活动现金流入小计809,604,553.27653,767,615.2623.84%筹资活动现金流出小计912,619,683.11635,282,920.4843.66%筹资活动产生的现金流量净额-103,015,129.8418,484,694.78-657.30%现金及现金等价物净增加额40,738,385.99-80,016,205.12-150.91%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明√适用□不适用（1）2019年度，经营活动产生的现金流量净额较2018年增加18,026.72万元,主要原因系：本期合理规范供应商付款所致。（2）2019年度，投资活动产生的现金流量净额较2018年增加6,933.57万元，主要原因系：本期对外投资支付的现金减少所致。（3）2019年度，筹资活动产生的现金流量净额较2018年减少12,149.98万元，主要原因系：本期偿还银行借款及分配现金股利增加所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明√适用□不适用经营活动产生的现金净流量51,345.77万元与本年度净利润32,225.65万元，相差19,120.12万元，主要差异原因如下：1、本期固定资产折旧、无形资产摊销及资产减值等影响22,968.09万元;2、本期财务费用中利息支出影响6,511.44万元；3、本期经营性应收项目增加影响-17,521.12万元，经营性应付项目增加影响7,692.44万元。三、非主营业务分析√适用□不适用单位：元金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性投资收益1,482,807.360.42%主要为投资AvivC&EMS、深圳市路维光电股份有限公司及购买银行理财产品形成。否公允价值变动损益否资产减值-22,668,161.68-6.40%主要为计提的坏账损失。否营业外收入1,342,272.290.38%主要为处置非流动资产毁损报废利得，及收到与日常活动无关的政府补贴和其他收入。否营业外支出2,927,857.790.83%主要为处置非流动资产毁损报废损失、罚款和对外捐赠。否四、资产及负债状况分析1、资产构成重大变动情况公司2019年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目√适用□不适用单位：元2019年末2019年初比重增减重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例货币资金527,871,258.3810.15%487,132,872.3910.24%-0.09%应收账款1,070,085,430.9720.57%935,857,470.9619.67%0.90%存货381,240,460.827.33%367,438,596.297.72%-0.39%投资性房地产110,478,726.212.12%114,589,927.712.41%-0.29%长期股权投资119,752,491.662.30%137,258,633.502.88%-0.58%固定资产1,594,542,555.9230.66%1,488,387,604.8131.28%-0.62%在建工程242,052,385.524.65%211,368,653.224.44%0.21%短期借款403,562,551.007.76%547,065,535.6111.50%-3.74%长期借款258,689,655.984.97%167,998,092.523.53%1.44%2、以公允价值计量的资产和负债√适用□不适用单位：元项目本期公允价值变动损益本期计提的减值计入权益的累计公允价值变动本期购买金额本期出售金额其他变动期初数期末数金融资产4.其他权益工具投资149,382,422.3166,322,003.10198,605,530.00金融资产小计149,382,422.3166,322,003.10198,605,530.00上述合计149,382,422.3166,322,003.10198,605,530.00金融负债0.000.000.00其他变动的内容不适用。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□是√否3、截至报告期末的资产权利受限情况项目期末账面价值受限原因货币资金28,662,424.41保证金应收票据82,229,643.05质押开票应收账款5,372,598.90借款质押固定资产308,703,887.41固定资产抵押/融资租赁合计424,968,553.77五、投资状况分析1、总体情况√适用□不适用报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度194,822,520.64171,244,438.1213.77%2、报告期内获取的重大的股权投资情况□适用√不适用3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况√适用□不适用单位：元项目名称投资方式是否为固定资产投资投资项目涉及行业本报告期投入金额截至报资金来源项目进度预计收益截止报未达到披露日期（如有）披露索引（如有）告期末累计实际投入告期末累计实现的收计划进度和预计收益金额益的原因子公司广州兴森快捷电路科技有限公司投资建设二期工程自建是印制电路板194,822,520.64337,666,714.54自有资金以及向金融机构借款85.00%0.000.00不适用2018年08月07日《关于子公司广州兴森快捷电路科技有限公司投资建设二期项目的公告》（公告编号：2018-08-046）刊登于《证券时报》和巨潮资讯网合计------194,82337,66----0.000.00------2,520.6,714.64544、以公允价值计量的金融资产√适用□不适用单位：元资产类别初始投资成本本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动报告期内购入金额报告期内售出金额累计投资收益期末金额资金来源其他120,579,644.000.0066,322,003.1046,380,000.004,860,000.001,034,742.48240,125,530.00自筹合计120,579,644.000.0066,322,003.1046,380,000.004,860,000.001,034,742.48240,125,530.00--5、募集资金使用情况√适用□不适用（1）募集资金总体使用情况√适用□不适用单位：万元募集年份募集方式募集资金总额本期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例尚未使用募集资金总额尚未使用募集资金用途及去向闲置两年以上募集资金金额2017年公开发行债券40,000039,711.46000.00%0不适用0合计--40,000039,711.46000.00%0--0募集资金总体使用情况说明1、经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】3226文核准，由主承销商民生证券股份有限公司承销，本公司采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行，债券基础发行规模为人民币2亿元、超额配售金额为人民币2亿元，债券面值每张人民币100元，平价发行，债券的票面利率为5.90%。募集资金总额为人民币400,000,000.00元，扣除承销费后募集资金净额为人民币397,000,000.00元。2017年7月24日，已由民生证券股份有限公司转入公司募集资金存储专户的银行，金额为人民币397,000,000.00元。截至2017年12月31日，公司募集资金专户募集资金余额为人民币9,931.18元。2、根据《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司关于公开发行公司债券（第一期）新增募集资金账户的公告》等发行申请文件的规定公司本次公开发行债券募集资金将全部用于补充流动资。3、2019年上半年累计使用募集资金补充流动资金0元。4、截止2019年12月31日募集资金账户余额人民币0元。，（2）募集资金承诺项目情况√适用□不适用单位：万元承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目补充流动资金否39,70039,711039,711100.000不适用否.46.46%承诺投资项目小计--39,70039,711039,711----0----.46.46超募资金投向不适用否00000.00%不适用否合计--39,70039,711039,711----0----.46.46未达到计划进度或不适用预计收益的情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明不适用超募资金的金额、不适用用途及使用进展情况募集资金投资项目不适用实施地点变更情况募集资金投资项目不适用实施方式调整情况募集资金投资项目不适用先期投入及置换情况用闲置募集资金暂不适用时补充流动资金情况项目实施出现募集不适用资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向不适用募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况（3）募集资金变更项目情况□适用√不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。六、重大资产和股权出售1、出售重大资产情况□适用√不适用公司报告期未出售重大资产。2、出售重大股权情况□适用√不适用七、主要控股参股公司分析√适用□不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况单位：元公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润广州市兴森电子有限公司子公司PCB中、低端样板的生产64,886,989.2337,374,207.84122,968,294.462,846,405.141,920,988.47宜兴硅谷电子科技有限公司子公司PCB中、高端中小批量板研发、生产699,806,215.54404,119,302.21415,463,206.8528,545,396.6928,643,655.58广州兴森快捷电路科技有限公司子公司PCB板、IC封装载板的研发、设计、生产与销售2,525,345,451.231,553,461,784.911,929,511,263.14153,739,541.03144,451,302.57兴森快捷香港有限公司子公司商业贸易899,214,263.86322,865,153.62553,114,268.2126,529,211.1425,304,500.63FinelineGlobalPTELtd.子公司印刷电路板贸易558,905,061.66337,350,342.971,009,980,648.3386,464,227.2976,300,991.89ExceptionPCBSolutionsLimited子公司印制线路板的销售与生产26,854,967.64-45,846,833.6070,419,380.441,703,893.852,126,713.75HarborELectronics,Inc子公司半导体测242,230,831.45152,925,585.69329,459,773.6022,175,027.7717,540,419.61试板的设计、生产、销售及贴装上海泽丰子公司半导体测148,882,8105,606,2185,969,050,565,0546,241,16试板销售，半导体科应用开发，技有限公设计以及45.2563.9157.696.853.30司一站式服务报告期内取得和处置子公司的情况√适用□不适用公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响FuchsbergerPCB&ElectronicsGmbH购买未有重大影响SpiritcircuitsLtd购买未有重大影响上海泽荃半导体科技有限公司设立未有重大影响主要控股参股公司情况说明（1）广州市兴森电子有限公司广州市兴森电子有限公司为本公司全资子公司，成立于2004年，注册资本1000万元人民币，公司的产品为PCB中、低端快件样板，报告期内，实现营业收入12,296.83万元，净利润192.10万元。（2）宜兴硅谷电子科技有限公司宜兴硅谷电子科技有限公司为本公司全资子公司，成立于2006年，注册资本48318.795万元人民币，公司的产品为PCB中、高端中小批量板，报告期内，实现营业收入41,546.32万元，净利润2,864.37万元，报告期内实现扭亏为盈。（3）广州兴森快捷电路科技有限公司广州兴森快捷电路科技有限公司本公司持有其89.48%股权，全资子公司兴森快捷香港有限公司持有其10.52%股权，成立于2006年，注册资本9504万美元，公司的产品为PCB中、高端快件样板、PCB中、低端小批量板、中、高端刚挠板、IC封装载板、SMT表面贴装，报告期内，实现营业收入192,951.13万元，净利润14,445.13万元。（4）兴森快捷香港有限公司兴森快捷香港有限公司为本公司全资子公司，成立于2005年，注册资本1200.128万美元，公司主营业务为PCB贸易和进出口业务，报告期内，实现营业收入55,311.43万元，净利润2,530.45万元。（5）FinelineGlobalPTELtd.本公司之全资子公司兴森快捷香港有限公司持有其75%股权，公司主营业务为PCB贸易，注册资本2018.25万美元，报告期内，实现营业收入100,998.06万元，净利润7,630.10万元。（6）ExceptionPCBSolutionsLimited本公司之全资子资兴森快捷香港有限公司持有其100%股权，成立于2013年，注册资本80万英镑，公司主营业务为PCB样板和小批量板，报告期内，实现营业收入7,041.94万元，净利润212.67万元，报告期内实现扭亏为盈。（7）HarborElectronicInc.HarborElectronicInc是兴森快捷香港有限公司全资子公司，成立于2015年，注册资本2500万美元，公司主营业务为半导体测试板的设计、生产、销售及贴装，报告期内，实现营业收入32,945.98万元，净利润1,754.04万元，报告期内实现扭亏为盈。（8）上海泽丰半导体科技有限公司上海泽丰半导体科技有限公司为全资子公司广州兴森快捷电路科技有限公司投资设立的控股子公司，持有其60%股权。成立于2015年8月，主要经营范围为半导体测试板销售，应用开发，设计以及一站式服务。报告期内，实现营业收入18,596.91万元，净利润4,624.12万元。八、公司控制的结构化主体情况□适用√不适用九、公司未来发展的展望（一）公司未来发展展望2020年，全球宏观经济面临更大的不确定性，贸易摩擦尚未得到有效解决，新冠疫情对于全球经济和产业链的负面影响仍在进一步强化，已经演绎成为可能影响2020年全球经济和产业走势的重大“黑天鹅”事件。目前，全球政府在解决贸易争端和新冠疫情方面尚未完全达成一致共识，外部政治经济局势面临高度的不确定性和复杂性。机遇与挑战并存，尽管面临贸易摩擦和新冠疫情的考验，但随着以5G、人工智能、大数据为代表的“新基建”国家战略的推进，作为基础产业的PCB行业仍面临长期战略机遇。根据Prismark预测，未来几年全球PCB市场仍将保持稳定增长，中国市场在全球PCB产业链中的地位会进一步强化，技术升级的方向日趋明确，尤其以高层板、IC封装基板为代表的高端产品会保持较高的增长率，显着优于普通单层板、双面板等常规产品的表现。国内半导体行业从设计——晶圆制造——封测代工产业链保持高景气度，有望提升以IC封装基板为代表的半导体封测材料行业的景气度，国产配套的需求仍将是IC封装基板行业未来发展的长期驱动力。在此背景之下，苦炼内功、夯实基础、增强抗风险能力、提升市场份额成为公司在现阶段的必然选择。战略方向上，公司仍将聚焦于PCB和半导体产业，保持稳定的研发投入以提升技术实力，继续推进“降本增效、卓越运营”的经营方针以提升经营质量，加强团队建设以提升整体战斗力，强化预算管控以提升经营效率和财务稳健性，在此基础上稳步推进IC封装基板、宜兴5G项目、SMT工厂等项目的开工建设和投产工作，加大客户开拓力度以争取更大的市场份额，保证公司实现有质量的增长目标。（二）可能面临的风险及应对措施1、宏观经济波动带来的风险贸易摩擦、新冠疫情对全球政治经济局势和产业格局形成重大挑战，内外部经济环境均面临更大的不确定性和复杂性，继而对公司的战略、经营管理形成挑战。公司将会密切关注全球经济、产业环境的变化趋势，通过苦炼内功、夯实基础、提升经营效率和财务稳健性来应对全球宏观经济波动所带来的风险和挑战，并通过持续的研发投入提升技术实力，加强团队建设提升整体竞争力，并稳步扩产、加大市场开拓力度，提升公司的行业地位和综合竞争实力。2、PCB市场竞争风险PCB行业下游应用领域广泛，参与者众多、且集中度低，市场竞争较为激烈。在全球PCB行业向中国内地转移的大趋势下，内资PCB同行经历一轮上市高峰，目前行业内超过20家上市公司，且仍在利用上市公司的融资能力优势积极扩产，未来随着产能逐步释放，国内PCB行业的竞争将更加激烈。虽然公司在PCB样板、小批量板和IC封装基板、半导体测试板等细分行业具有相对领先优势，但仍面临较为严峻的竞争形势。公司一方面将通过持续的研发投入提升技术实力，把握住PCB和半导体行业升级的产业机会；另一方面，按照既定的战略方向和经营策略，提升管理能力、产能规模、信息化能力，积极应对市场竞争。3、应收账款风险本报告期内，公司应收账款余额107,008.54万元，占公司总资产的20.57%，占营业收入的28.13%，较去年同期有所上升。尽管公司应收账款账龄较短，但由于绝对数额较大，一定程度上增加了应收账款管理的成本与发生坏账的风险。公司制定了适当的信用策略及管控政策，根据客户的动态财务状况和履约情况，对新老客户的信用等级及时跟踪评估，对信用等级低的客户实行淘汰制度，适时调整信用额度及收款期限，利用订单系统对部分客户实施锁定订单等措施，并通过加强前端授信、事中监控、后端款项清收，做好应收账款风险管控工作；同时，进一步优化客户结构，打造能够抵御风险的优质客户群体。4、原材料价格波动风险公司生产的主要原材料包括覆铜板、半固化片、干膜、金盐、油墨、铜球及铜箔等，上述主要原材料价格受国际市场铜、黄金、石油等大宗商品的影响较大。主要原材料供应链的稳定性和价格波动将影响公司的生产稳定性和盈利能力。同时，受政府环保政策趋严影响，也会驱动原材料价格进一步上涨，这将会使公司产品面临一定的原材料成本上升压力。公司将会通过优化订单结构、提升工艺能力、加快技术创新、提高核心客户和供应商合作深度等方式保障供应链的安全稳定，降低原材料价格上涨所带来的压力。5、经营管理风险随着公司的持续发展，经营地域进一步拓展，资产规模持续增长，业务范围和产品类别进一步扩大，对公司在战略实施、运营管理、奖惩机制、财务管控等方面均面临更高的要求和更大的挑战。如果公司不能适应规模快速扩张，及时调整并完善组织模式和管理体系，实现管理升级，将可能影响公司市场竞争力，面临管理风险。公司将通过实施有效的激励机制、优化并完善管理制度和流程体系、健全内部控制机制的方式，加强对各分子公司、事业部的管理，尽可能消除规模扩张所带来的管理风险。十、接待调研、沟通、采访等活动1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表√适用□不适用接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引2019年01月04日实地调研机构2019年1月7日刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《2019年1月4日投资者关系活动记录表》（编号：2019-01-001）2019年01月18日实地调研机构2019年1月21日刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《2019年1月18日投资者关系活动记录表》（编号：2019-01-002）2019年03月25日实地调研机构2019年3月26日刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《2019年3月25日投资者关系活动记录表》（编号：2019-03-001）2019年05月21日实地调研机构2019年5月21日刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《2019年5月21日投资者关系活动记录表》（编号：2019-05-001）2019年06月10日实地调研机构2019年6月12日刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《2019年6月10日投资者关系活动记录表》（编号：2019-06-001）2019年06月19日实地调研机构2019年6月21日刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《2019年6月19日投资者关系活动记录表》（编号：2019-06-002）2019年08月16日实地调研机构2019年8月19日刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《2019年8月19日投资者关系活动记录表》（编号：2019-08-001）